

Presse-Information

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

(07/25) Elektronikgehäuse mit passenden Kühlkörpern und optimierten Leiterplatten-Layouts bieten eine optimale Kühlung und Leistungssteigerung der Geräte. Für Elektronikgehäuse der Serien BC, ME-IO, ICS und UCS bietet Phoenix Contact daher die Kombination aus passenden Kühlkörpern und einem einzigartigen Simulationservice an, der die thermische Effizienz des Geräts maximiert.

Durch die flexible Kombination von Aluminiumkühlkörpern und Kunststoffgehäusen bieten diese Hybridsysteme eine ideale Lösung für die thermische Optimierung der Geräte. Die modulare Bauweise und passgenaue Kühlkörper für die jeweiligen Gehäusesysteme ermöglichen in unterschiedlichen Anwendungen eine gezielte Wärmeableitung. Durch die aufeinander abgestimmten Komponentenanordnungen und präzise Kühlung wird ein optimales Raum-Leistungsverhältnis realisiert.

Die Integration von Aluminiumkühlkörpern in Kunststoffgehäusen sorgt für eine maximale Wärmeableitung ohne den Einsatz zusätzlicher aktiver Kühlsysteme. Sie ist somit ideal für Anwendungen, bei denen Höchstleistung gefragt ist.

Elektronikgehäuse von Phoenix Contact mit Aluminiumkühlkörpern schaffen die richtigen Voraussetzungen für kompakte Anwendungen. Denn je effizienter die Kühlung ist, desto höher ist die mögliche Leistungsdichte und umso anspruchsvollere Umgebungsbedingungen sind realisierbar – bei gleichzeitig maximaler Ausnutzung des verfügbaren Bauraums.

5717

Press release

Electronics housings with thermal simulation

(07/25) Electronics housings with corresponding heatsinks and optimized PCB layouts offer optimal cooling and increased device performance. For BC, ME-IO, ICS, and UCS series electronics housings, Phoenix Contact therefore offers a combination of suitable heatsinks and a unique simulation service that maximizes the thermal efficiency of the device.

Through the flexible combination of aluminum heatsinks and plastic housings, these hybrid systems provide the ideal solution for the thermal optimization of devices. The modular design and tailor-made heatsinks for the respective housing systems enable targeted heat dissipation in various applications. The coordinated component arrangements and precise cooling ensure an optimum space/performance ratio.

The integration of aluminum heatsinks in plastic housings ensures maximum heat dissipation without the use of additional active cooling systems. This is therefore ideal for applications where maximum performance is required.

Electronics housings from Phoenix Contact with aluminum heatsinks create the right conditions for compact applications. This is because the more efficient the cooling, the higher the possible power density and the more demanding the ambient conditions can be – while also ensuring maximum utilization of the available installation space.

5717